



Sound Bonding Application

Sound Power Multi-Step Bonding

〈更に進化したMSBでLiB積層箔100枚以上の複数ヶ所同時接合〉

【クリップ合金接合 /Clip-Ingot Tool】

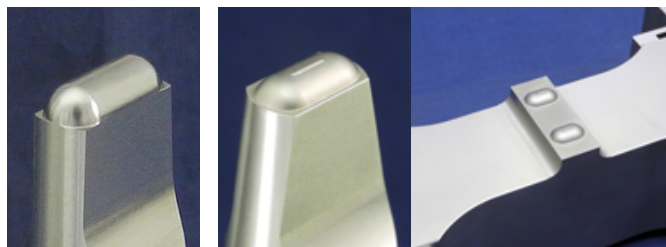
CIBのツールの先端形状は丸みを帯びておりエネルギーが集中します。これまでのメッシュツールによる接合とは異なり、ホッチキスで綴じた様な**傷跡が残らずコンタミが発生しない**ソフトタッチの〈綺麗〉な接合方法です。(Patents pending)

【進化したMST/Multi-Step Tool】

MSTでは丸みを帯びた先端形状が多段に重なりエネルギーがより先端部に集中し、スムーズに接合することができます。その結果**接合時間を短縮でき、積層箔へのダメージをより軽減し、接合音が小さくなり、接合強度が更に増し**ます。(Patents pending)

【更にMSB/Multi-Step Bondingとは?】

MSBでは、丸みを帯びたMSTがソリッドホーン上にダイレクトに備わることで剛性が増し**100枚以上のLiB等の積層金属箔が焼けることなく、かつ複数箇所同時に、短時間でスムーズ**に接合できます。(Patents pending)



CIB ツール MST ツール MSB ソリッド ホーン



[アルミ積層箔とアルミプレート
の2カ所同時接合]



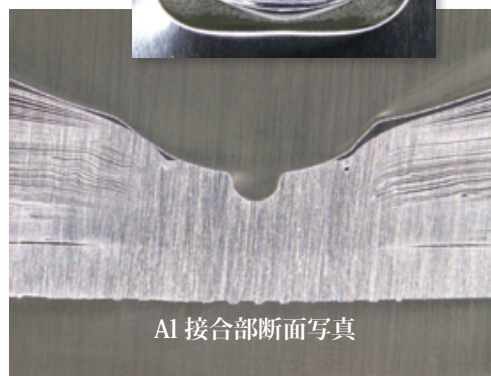
[銅積層箔と銅プレート
の2カ所同時接合]



[接合部拡大]

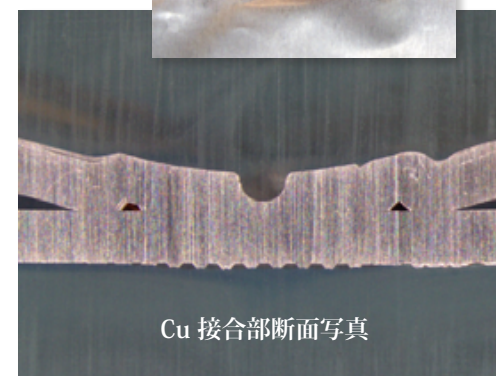


[接合部拡大]



Al 接合部断面写真

[アルミ箔 t=15 μm x 100枚]
保護シート無し



Cu 接合部断面写真

[銅箔 t=8 μm x 100枚]
保護シート無し